



2025年12月16日

各 位

会 社 名 ア オ イ 電 子 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 木 下 和 洋
(コード番号 6832 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 青 木 良 二
(TEL 087-882-1131)

業務提携契約の締結に関するお知らせ

当社は、インドにおいて半導体後工程（OSAT※1）事業の立ち上げを進める Kaynes Semicon Private Limited※2（以下「Kaynes」）を支援するため、総合商社である三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀 健一、以下「三井物産」）と連携し、三社間において業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、本契約に基づき、これまでに蓄積してきた知見と経験を活かし、三井物産と連携のもと、Kaynes による半導体後工程事業の展開を支援してまいります。加えて、Kaynes と日系の半導体関連企業との橋渡し役を担うことで、新たなサプライチェーンの構築を推進し、日本の半導体産業の成長と将来の可能性の拡大に貢献してまいります。なお、当社は 2025 年 4 月に発足した日本 OSAT 連合会の一員として国内の半導体後工程の発展、基盤整備にも取り組んでまいります。

半導体は、国家の競争力や安全保障の観点から戦略的に極めて重要な物資とされており、各国で製造の内製化やサプライチェーンの再構築が進められています。インドにおいても「Make in India」政策のもと、製造業の強化が推進されており、半導体分野には政府による多額の支援が行われています。

Kaynes は、2024 年 9 月に OSAT 事業に関する政府承認を取得し、2027 年前半の事業開始を目指して、競争力のある OSAT 事業の立ち上げを進めています。

当社は、三井物産と協力し Kaynes の成長を継続的に支援してまいります。また、この取り組みを通じて、グローバルにおける半導体エコシステムの多極化と強靱化に寄与するとともに、日印間の経済連携の深化、持続可能な半導体産業の発展、新たな雇用の創出、そしてデジタル社会を支える基盤づくりに貢献してまいります。

※1：Outsourced Semiconductor Assembly and Test の略

※2：Kaynes Semicon Private Limited は、インドで EMS 事業を手掛ける Kaynes Technology India Limited の完全子会社であり、インドの半導体製造分野におけるイノベーション、信頼性、そして国際競争力の向上に取り組んでいます。同社は、国内で高まる様々な分野の半導体需要に応えるため、最先端製造工場と先端パッケージング施設の構築に注力しております。

以 上